

公司代码：605111

公司简称：新洁能

无锡新洁能股份有限公司

2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以截至 2024 年 3 月 27 日的总股本（扣除回购专户中的股份数量）298,168,303 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.17 元（含税），预计派发现金红利 64,702,521.75 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，预计拟转增 119,267,322 股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额以及转增数量，并将另行公告具体调整情况（注：因涉及零碎股处理，最终股本变动情况以中国结算上海分公司登记的股本结构为准）。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称

A股	上海证券交易所	新洁能	605111	/
----	---------	-----	--------	---

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖东戈	陈慧玲
办公地址	无锡市新吴区电腾路6号	无锡市新吴区电腾路6号
电话	0510-85618058-8101	0510-85618058-8101
电子信箱	Info@ncepower.com	Info@ncepower.com

2 报告期公司主要业务简介

1、行业特点及发展趋势

公司主要供应高性能、高质量、高可靠性“硅基、化合物”半导体功率器件、集成电路及模块产品，根据中华人民共和国统计局发布的《国民经济行业分类》（标准编号：GB/T4754-2017），公司所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”大类下“半导体分立器件制造（3972）”；根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

分立器件行业是半导体产业中一个重要分支。据国家统计局规模以上工业统计数据显示，近几年来，分立器件行业规模以上企业主营业务收入占半导体行业规模以上企业主营业务收入的比重维持在 22%—25% 之间。

功率半导体是电子装置电能转换与电路控制的核心，在电路中主要起着功率转换、功率放大、功率开关、线路保护、逆变（直流转交流）和整流（交流转直流）等作用。随着国家对电能替代和节能改造的推进，迫切需要高质量、高效率的电能，目前世界上大多数电能是经过功率半导体处理后才能使用，这一比例还将进一步扩大。

功率半导体自诞生以来经过七十多年的研究应用，从基材的迭代、结构设计的优化、先进封装形式、大尺寸晶圆的应用等多个方面进行技术创新，演进的主要方向为更高的功率密度、更小的体积、更低的功耗及损耗，其结构设计朝着理想目标不断改进，以适应更多应用场景的需要。据 Yole 数据，功率半导体器件每隔二十年将进行一次产品迭代，相比其他半导体，迭代周期相对慢，每一代芯片都拥有较长的生命周期。

发展至今，功率半导体已拥有较好的国内产业链基础和相对成熟的技术，中低端国产功率半导体产品已形成规模化、国产化，从依赖进口转变为国内自给自足。在中高端领域，如 SGT MOSFET、SJ MOSFET、IGBT、化合物半导体等，由于起步晚、设计门槛高、工艺相对复杂以及

缺乏验证机会等原因，国内厂家依然在追随海外厂家技术发展路线。新洁能从成立之初即基于全球半导体功率器件先进理论技术开发先进产品，成为国内中高端器件的领军企业，专注于产品设计与推广，精准把握市场需求和供应节奏，与国际一流代工厂长年紧密合作，在产品设计与推广、工艺融合优化、产品规划、产能调配等方面达成了优秀水平。

2、市场规模分析

2023年，受全球经济增速放缓、下游应用市场景气度波动、局部国际形势恶化等因素的综合影响，全球半导体行业市场增速有所放缓。Gartner公司发布了2023年全球半导体行业报告，显示全球半导体收入总额为5,330亿美元，较2022年下降11.1%。据中华人民共和国海关总署公布的2023年进出口主要商品数据，2023年全年集成电路出口2,678.3亿个，同比下降1.8%；全年集成电路进口4,796亿个，同比下降10.8%。

尽管2023年全年数据经历了周期性下滑，但跟踪世界半导体贸易统计（WSTS）组织的月度数据，2023年第三季度开始呈现增长趋势，第四季度持续回暖，WSTS预测2024年全球半导体销售额将增长13.1%。

功率半导体的市场规模在全球半导体行业的占比在8%—10%之间，结构占比保持稳定。半导体功率器件几乎用于所有的电子制造业，包括计算机、网络通信、消费电子、汽车电子、工业电子等电子产业，新兴应用领域如新能源汽车/充电桩、数据中心、风光发电、储能、智能装备制造、机器人、5G通讯的快速发展也拉动了功率器件市场的增长，因此行业周期性波动较弱，全球功率半导体市场规模稳步增长。根据Omida的数据及预测，2023年全球功率半导体市场规模达到503亿美元，预计2027年市场规模将达到596亿美元，其中功率IC市场占54.8%，功率分立器件占30.1%，功率模块占15.1%；中国功率半导体的市场规模，预计2024年将达到206亿美元，占全球市场约为38%。中国作为全球最大的功率半导体消费国，未来市场发展前景良好。

（1）从产品品类角度分析

功率半导体按器件集成度可以分为分立器件（含模块）、功率模块和功率IC三大类。其中，功率半导体分立器件，按照器件结构划分，可分为二极管、功率三极管、晶闸管、MOSFET、IGBT、SiC/GaN等，其中以MOSFET、IGBT、SiC MOSFET为代表的功率器件需求旺盛，市场规模如下：

产品品类	特点	市场规模测算
MOSFET	具有开关速度快、输入阻抗高、导通内阻小、易于驱动、热稳定性好等优点，既可在低电流和低电压条件下工作，也可用于大电	根据WSTS统计数据，2023年全球MOSFET市场规模为143亿美元，预计2026年将增长至160亿美元；2023年中国MOSFET市场规模约为51亿美元，占全球市场的36%。预计2026年中国

	流开关电路和高频高速电路，应用场景广泛。	MOSFET 市场规模将增长至 57.6 亿美元，增速高于全球市场增速。 高压 MOSFET 产品占比由 2020 年的 29% 增长至 36%，出货量复合增速达 8.1%
IGBT	能源变换与传输的核心器件，可在更高电压下持续工作，具有高输入阻抗、低导通压降、驱动功率小而饱和压降低的特点，功率增益更大，广泛应用于直流电压为 600V 及以上的变流系统。	WSTS 数据显示，2023 年全球 IGBT 市场规模达到 90 亿美元，预计 2026 年将达到 121 亿美元；中国是全球 IGBT 最大的消费市场，2023 年中国 IGBT 市场规模达 32 亿美元，预计到 2026 年中国 IGBT 市场规模将达到 42 亿美元。
第三代半导体	碳化硅器件：具有耐高压、大电流、耐高温、高频、高功率和低损耗等众多优点。 氮化镓器件：具有高电子迁移率、宽频带、高击穿场强、耐高温尺寸小等特点。	结合 Yole 数据测算，碳化硅功率半导体器件市场将从 2021 年 10.9 亿美元增至 2027 年 62.97 亿美元，年复合增长率 34%。 氮化镓功率半导体器件市场将从 2021 年 1.26 亿美元增至 2027 年 20 亿美元，年复合增长率 59%。

(2) 从应用领域角度分析

随着新能源汽车和充电桩、光伏及储能、AI 服务器及数据中心、无人机、5G、物联网、人工智能等新兴市场为功率半导体行业带来新的应用场景和需求，工业自动化、消费电子等支柱行业的稳步发展，作为终端产品核心元器件的高性能功率器件使用需求势必不断增加。

①新能源汽车及充电桩：新四化持续推动功率器件市场增长

汽车产业是我国经济发展的重要支柱产业，加速新能源汽车创新和开发是汽车产业的重点发展方向，我国新能源汽车产业链逐步成熟，产品向多元化发展。随着新能源汽车购置税减免政策的延续、用车环境优化、限牌限号地方政策等因素的催化下，新能源汽车的优势逐渐显露，预计未来渗透率将不断提高。

中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)数据显示,2023 年我国新能源汽车产销量分别达 958.7 万辆和 949.5 万辆,同比分别增长 35.8%和 37.9%,市场占有率达 31.6%。2023 年我国汽车出口 491 万辆(整车出口 485.28 万辆),出口量首次超过日本,成为全球第一大汽车出口国。2024 年我国汽车市场有望继续保持稳中向好发展态势,中汽协发布的《2024 中国汽车市场整体预测报告》预测 2024 年新能源汽车销量为 1,150 万辆左右,出口量为 550 万辆左右;2024 年我国汽车总销量将达到 3,100 万辆,同比增长 3%。乘用车销量在 2,680 万辆左右,同比增长 3.1%。新能源汽车销量将达到 1,150 万辆左右,同比增长 20%。新能源汽车成为引领我国汽车产业转型的重要力量。

新四化即电动化、智能化、网联化、共享化,电动化指的是新能源动力系统领域;智能化指的是无人驾驶或者驾驶辅助子系统;网联化指的是车联网布局;共享化,指的是汽车共享与移动出行。在新四化趋势下,汽车产业进入百年未有的大变革时代,新能源汽车迎来大发展,汽车对

芯片的需求量在不断增加。从基本的电力系统控制到无人驾驶技术、高级驾驶辅助系统和汽车娱乐系统，都对电子芯片有着极大的依赖。电能取代燃油成为汽车驱动的能量来源，功率半导体作为实现电能转换的核心器件，新能源车功率器件单车用量约为传统燃油车的 2 至 3 倍。中汽协提供的数据显示，传统燃油车所需汽车芯片数量为 600 至 700 颗，而电动车所需的汽车芯片数量将提升至 1,600 颗/辆，更高级的智能汽车对芯片的需求量或将有望提升至 3,000 颗/辆。电机驱动、照明、热管理、电动汽车主驱逆变器、DC/DC、升压器和 OBC（车载充电器）等产品将依据各自的工作功率大小，选择不同的功率半导体器件，高、中、低压硅基 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET 均有广泛使用。

充电桩是推动汽车电动化的基础设施，新能源汽车的高速增长的态势，也带动充电桩产业步入快速发展期，全国各地充电桩建设正在提速。中国充电联盟数据显示，2023 年，充电基础设施增量为 338.6 万台。国家能源局数据显示，截至 2023 年底，我国充电基础设施总量达 859.6 万台，同比增长 65%。交通运输部印发《关于加快推进 2024 年公路服务区充电基础设施建设工作的通知》，通知中提到，2024 年全国计划新增公路服务区充电桩 3,000 个、充电停车位 5,000 个，持续提升公路沿线充电服务保障能力。适合公路场景的“超快充、大功率”充电设施成为发展方向，对充电桩的功率密度、电能转换效率、工作温度、可靠性提出更高要求。从直流充电桩相关零部件分解可以看出，充电机是充电桩的最核心部件，成本占充电桩的 50% 以上，而功率半导体是充电机的最核心组成部分，成本占充电机的一半以上。

②AI 服务器及数据中心：新技术发展带来广阔空间

随着 5G 网络商用的持续推进，云计算、大数据、人工智能等新一代技术的快速演进，智慧城市、数字政府、工业互联网等应用的迅速发展，数据中心作为数据存储和计算的信息基础设施，其需求也将同步持续增长。IDC 预计，全球对于数据中心的建设投资将保持加速增长状态，从建设数量来看，2022—2026 年，全球新建数据中心数量将以 8.6% 的年复合增长率（CAGR）增长。国务院总理李强在北京调研时明确指出：“人工智能是发展新质生产力的重要引擎。要加强前瞻布局，加快提升算力水平，推进算法突破和数据开发使用，大力开展‘人工智能+’行动，更好赋能千行百业”。

服务器是数据中的一部分，负责执行具体的计算和存储任务，数据中心则提供了一个更加全面和集中的环境，用于管理和运营这些服务器和其他 IT 设备。服务器根据场景需求变化，目前市场格局为传统服务器、云服务器、AI 服务器和边缘服务器四足鼎立。受益于“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家利好政策的驱动，超大规模数据中心、传统企业以及用户对 AI、混合

云等新兴应用的采购需求更趋旺盛，为服务器、集成电路等相关产业带来发展机遇。国内外厂商加速布局千亿级参数量的大模型，训练需求及推理需求高速增长，共同驱动算力革命，并助推 AI 服务器市场及出货量高速增长。据 IDC 与浪潮信息的数据显示，2023 年全球 AI 服务器市场规模为 211 亿美元，预计 2026 年达 347 亿美元，5 年 CAGR 达到 17.3%；预计 2025 年中国 AI 服务器市场规模达到 103.4 亿美元。

以 SGT MOSFET、SJ MOSFET、Gate Driver、Dr MOS 为代表的功率半导体在服务器电源供电、CPU/GPU 主板供电、同步整流、PFC、LLC、散热风扇等服务器重要部件中有广泛应用。以浪潮、华为、联想、新华三为代表的国产服务器厂商在全球市场份额占比超 35%，其市场规模及占有率的提升给中高端国产功率器件带来广阔空间。

③光伏储能：库存改善、加速渗透

随着全球制定“碳达峰、碳中和”目标，带来了更多绿色能源发电、储能需求，我国能源安全保障能力持续增强，能源绿色低碳转型步伐不断加快，尤其是以光伏为代表的新能源产业。根据国家能源局数据，2023 年国内光伏新增装机达到 216.88GW，同比大幅增长 148%，接近此前四年新增装机总和。截至 2023 年 12 月底，国内太阳能发电装机容量约 610GW，正式超越水电约 420GW 的装机规模，成为全国装机量第二大电源形式，在电力能源结构主体地位进一步提升。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华预测，2024 年中国新增光伏装机保守情况达到 190GW，同比下滑；乐观情况下同比略有上升，达 220GW，2024 年全行业首要任务是确保光伏产业稳定健康发展，防止大起大落。

中国是全球最大的光伏市场，同时中国光伏企业在国际市场上竞争优势明显，出口量持续增长。作为光伏发电系统的核心设备，逆变器的作用是将光伏组件产生的直流电转换为满足电网要求的交流电，是光伏系统中重要的平衡系统部件之一。全球光伏逆变器出货量靠前的企业均为中国企业，占全球光伏逆变器总出货量的大部分，且呈现向头部集中的趋势。尽管逆变器海外市场受库存积压、政策及经济形势波动的影响，导致不确定性和贸易性较高，但我国逆变器企业正加快拓展海外市场。根据中国海关总署数据显示，2023 年我国逆变器出口实现 99.54 亿美元，同比 2022 年的 89.38 亿美元，上升 11.37%。与此同时，逆变器出口环比改善，库存去化进展超市场预期。

IGBT 器件及模块、中高压 MOSFET、碳化硅等功率器件是光伏逆变器的核心零部件，在逆变器中承担着功率变换和能量传输的作用，决定着光伏逆变器的性能高低，直接影响光伏系统的稳定性、发电效率以及使用寿命，是逆变器的核心，其市场规模将随下游装机量增加同步增长。

IGBT 单管及模块占光伏逆变器价值量的 15%至 20%，不同的光伏电站需要的 IGBT 产品略有不同，如集中式光伏主要采用 IGBT 模块，而分布式光伏主要采用 IGBT 单管或模块。

④传统领域：工业、家电及其他市场稳健增长

根据 TrendForce 统计，全球功率半导体下游应用中，工业占比 35%，消费电子占比 19%，其巨大市场规模成为功率半导体稳定的基本盘。

工业方面，我国处于工业 4.0 快速发展时期，在《“十四五”智能制造发展规划》中政府提出明确发展目标：到 2025 年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到 2035 年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。工业 4.0，即第四次工业革命，是生产中的物联网，可使整个价值链连接在一起，智能机器将彼此交换信息，并自行组织，整个价值链中的流程将实现互联和自动化。因此，整个生产将变得更高效率、更敏捷。工业自动化是工业 4.0 的关键之一，主要利用电子电气、机械、软件组合实现，即通过计算机控制系统和自动化机械来代替人类决策和参与制造过程，使工厂的生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化，并具有可控性及可视性，同时也能提高生产速度、控制质量和提高安全性。功率半导体作为实现整流、变频的主要器件之一在工业 4.0 的实现当中发挥着不可替代的作用。

家电方面，变频家电能够智能调节压缩机转速，从而减少能源浪费，变频家电相比传统家电能够减少高达 30%至 40%的电力消耗，且能够在较宽的电压范围内正常工作，低噪音更环保，在节能减排的环保趋势及消费者需求升级下，我国变频家电渗透率不断提升。白色家电一般要求在家中使用寿命 5 至 10 年，产品稳定性、可靠性要求高，技术门槛高。功率半导体在家电实现两大功能：电流转换（交/直流电变换）、电源供应（电流升/降压输出），是变频家电的核心。

除上述应用外，功率半导体在安防、医疗设备、锂电保护、5G 通信、物联网等领域均有大量应用，市场规模将随经济发展、技术迭代、新应用普及等因素而稳步提升。

1、主要业务

公司的主营业务为 MOSFET、IGBT 等半导体芯片、功率器件和功率模块的研发设计及销售。公司凭借多年技术积累及持续自主创新，在国内率先构建了 IGBT、屏蔽栅 MOSFET（SGT MOSFET）、超结 MOSFET（SJ MOSFET）、沟槽型 MOSFET（Trench MOSFET）四大产品工艺平台，并已陆续推出车规级功率器件、SiC MOSFET、GaN HEMT、功率模块、栅极驱动 IC、电源管理 IC 等产品，可全面对标国际一线大厂主流产品并实现大量替代。公司产品技术先进且系列齐全，目前产品型号 3,000 余款，电压覆盖 12V~1700V 全系列，重点应用领域包括新能源汽车

及充电桩、光伏储能、AI 服务器和数据中心、无人机、工控自动化、消费电子、5G 通讯、机器人、智能家居、安防、医疗设备、锂电保护等十余个长期被欧美日功率半导体垄断供应的行业。

2、经营模式

公司的芯片产品主要由公司完成产品设计方案后，交由芯片代工企业进行生产；功率器件产品主要由公司通过子公司以及委托外部封装测试企业对芯片进行封装测试而成。公司全资子公司电基集成已建设先进封测产线并持续扩充完善，目前已实现部分芯片自主封测并形成特色产品；子公司金兰半导体已建成先进功率模块生产线，以满足光伏储能、汽车等重点应用领域客户的需求。

3、市场地位

公司为国内领先的半导体功率器件设计企业，在中国半导体行业协会发布的中国半导体功率器件企业排行榜中，2016 年以来公司连续多年名列“中国半导体功率器件十强企业”。公司基于全球半导体功率器件先进理论技术开发领先产品，是国内率先掌握超结理论技术、并量产屏蔽栅功率 MOSFET 及超结功率 MOSFET 的公司，也是国内最早在 12 英寸工艺平台实现沟槽型 MOSFET、屏蔽栅 MOSFET 量产的公司。同时，公司是国内最早同时拥有 IGBT、屏蔽栅 MOSFET（SGT MOSFET）、超结 MOSFET（SJ MOSFET）、沟槽型 MOSFET（Trench MOSFET）四大产品平台的本土企业之一，产品电压已经覆盖了 12V~1700V 的全系列产品，为国内 MOSFET、IGBT 等半导体功率器件市场占有率排名前列的本土企业。根据 Omdia 统计数据，2021 年国内 MOSFET 市场销售额排名中，含英飞凌、安森美等国际厂商在内公司排名第 5，其中在设计领域公司名列第一。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	4,339,720,370.31	3,989,496,638.01	8.78	1,891,981,304.07
归属于上市公司股东的净资产	3,642,558,105.24	3,362,694,574.64	8.32	1,536,921,867.36
营业收入	1,476,561,366.82	1,810,946,756.88	-18.46	1,510,738,793.41
归属于上市公司股东的净利润	323,116,344.25	435,180,979.82	-25.75	416,405,470.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,369,345.44	411,743,783.42	-26.08	407,774,008.49
经营活动产生的现金流量净额	475,469,445.87	273,308,464.57	73.97	450,884,685.73

加权平均净资产收益率（%）	9.25	18.77	减少9.52个百分点	30.99
基本每股收益（元/股）	1.13	1.52	-25.66	1.50
稀释每股收益（元/股）	1.13	1.52	-25.66	1.50

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	373,676,238.37	384,808,894.09	345,778,453.35	372,297,781.01
归属于上市公司股东的净利润	64,952,655.75	82,660,261.19	67,279,915.68	108,223,511.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,747,565.51	74,216,966.03	64,161,032.47	102,243,781.43
经营活动产生的现金流量净额	19,251,651.94	128,608,657.89	103,785,820.29	223,823,315.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

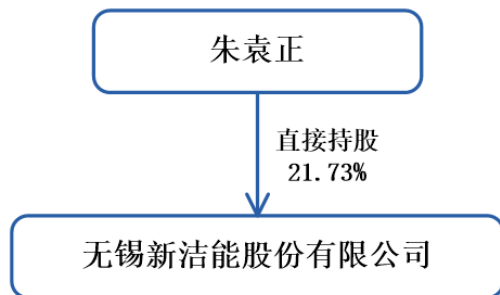
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）								66,872
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								66,496
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
前 10 名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质	
					股份 状态	数量		
朱袁正	18,514,944	64,802,304	21.73	0	无	0	境内自然 人	
上海贝岭股份有限公 司	3,378,852	12,942,482	4.34	0	无	0	境内非 国有法 人	
无锡金投控股有限公	2,169,551	7,593,427	2.55	0	无	0	境内非	

司							国有法人
全国社保基金四零六组合	2,522,087	7,374,103	2.47	0	无	0	其他
叶鹏	1,006,880	3,524,080	1.18	74,480	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-1,918,326	3,153,812	1.06	0	无	0	其他
邵君良	3,136,916	3,136,916	1.05	0	无	0	境内自然人
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	1,508,213	2,970,205	1.00	0	无	0	其他
郭艳芬	97,165	1,871,165	0.63	0	无	0	境内自然人
基本养老保险基金一六零五二组合	490,328	1,716,148	0.58	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱袁正、叶鹏为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司共实现营业收入 147,656.14 万元，较去年同期减少 18.46%；其中主营业务收入 147,083.92 万元，较去年同期减少 18.51%；归属于上市公司股东的净利润 32,311.63 万元，较去年同期减少 25.75%。业绩变化的主要原因系：2023 年度，公司下游应用市场的整体景气度延续了 2022 年第四季度以来的下行趋势，主要系经济环境下行导致下游需求减弱、国内晶圆代工厂更多产能释放以及功率半导体行业竞争加剧等多方面因素影响所致。同时，伴随着国际形势的不断恶化、国际半导体厂商从原本追逐高毛利到与中国半导体品牌开展价格竞争，公司面临着新的挑战。但与此同时，公司积极应对市场变化和响应客户需求，利用技术和产品优势、产业链优势等，持续优化产品结构、市场结构和客户结构，将产品导入并大量销售至新能源汽车和充电桩、光伏和储能、AI 服务器和数据中心、无人机等新兴领域客户，并开发出更多的行业龙头客户，进一步扩大了公司在高端市场的应用规模及影响力。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用